

Job Detail

Company Code:30368 Job Code:20231221-091-01-023

Manager Level

Position Title	【佐賀/鳥栖】◆金型設計 ?半導体産業を支える超精密金型/プライム市場上場?
Recruiter Company	株式会社 リクルート (リクルートエージェント / Recruit Agent)
Company Name	T O W A (株)
Activated / Updated	2024-06-04 / 2024-06-04
Job Type	Manufacturing (Automobile/Plant Engineering/Precision Equipment) - Control - Programmer
Industry	Electronics, Components, and Semiconductor Manufacturing
Location	Asia Japan Saga
Job Description	<p>■当社製品の根幹を担う、半導体封止金型の開発/設計をお任せします。 ■世界TOPシェアを誇る当社の半導体モールドディング装置ですが、その技術を支えるのは、世界屈指の半導体封止技術を実現する金型にあります。</p> <p>【具体的には】 ■金型設計 (CAD) ■開発設計、構想検討 ■金型の成形評価、成形プロセスの確立</p> <p>《特徴》当社のモールドディング技術は、最先端から汎用半導体デバイスまで幅広く採用されており、生成AI、スマホ、自動車、LED証明等で皆さんの便利で快適な暮らしを陰で支えています。 また、超精密加工技術で新たな分野へ展開する新事業にも取り組んでいます。</p>
Company Info	<p>■半導体製造装置の開発・製造・販売 ■半導体製造用精密金型の開発・製造・販売</p> <p>■ファインプラスチック成形品の製造・販売</p> <p>従業員数 597名</p>
Working Hours	08:30～ 17:30
Qualifications	<p>【いずれも必須】 ■機械設計経験 ■機械、機械製図の基礎知識をお持ちの方 ■ビジネス英語(客先購入仕様書の内容確認、メールでのやり取り等の初級レベル)</p> <p>【歓迎】 ■半導体製造後工程の業務経験</p> <p>【やりがい】 ■常に進化し続ける半導体業界において、お客様に必要とされる金型の設計も都度オーダーメイドやアレンジも必要とされます。その中で設計者として、納期やコストなど制約もある中で、自ら考えたアイデアを形にしていく達成感、やりがいがあります。</p> <p>■少人数のチームで設計を進めていくため、アイデア出しからお客様の工場でのセッテアップまで幅広く関わっていただけます。</p>
English Level	Business Conversation Level (TOEIC 735-860)
Japanese Level	Fluent(JLPT Level 1 or N1)
Salary	JPY - Japanese Yen JPY 4000K - JPY 6000K
Holiday Description	年間休日 123日
Job Contract Period	正社員